

## 2026年度春季大会 一般研究発表講演の分科会セッションテーマ

(Session Themes of Divisions for General Sessions at 2026 Spring Meeting)

重点テーマは、分科会として新しいトピックや議論が必要なものなどを取り上げて設定しています。

	中分類 : Subcategories(分科会名)		記号	小分類	Further Categories
G1	粉体機能科学分科会 Powder Function Science Division	セッションテーマ	G1-①	粉末製造プロセス	Powder Production
		セッションテーマ	G1-②	粉末複合化プロセス	Powder Composite Process
G2	粉末焼結プロセス分科会 Powder Sintering Process Division	セッションテーマ	G2-①	粉末（超微粉、均粒粉、急冷凝固粉、複合粉末、粉末表面処理、ゾルゲル法、ケミカルプロセス、製造装置など）	Powder (Ultrafine powder, Uniform particle size powder, Rapidly solidified powder, Composite powder, Powder surface treatment, Sol-gel process, Chemical process, Manufacturing equipment, etc.)
		セッションテーマ	G2-②	混合（メカニカルアロイング、メカニカルミリング、混合機、スプレードライヤーなど）	Mixing (Mechanical Alloying, Mechanical grinding, Mixer, Spray dryer, etc.)
		セッションテーマ	G2-③	成形（圧縮成形、CNC プレス、温間成形、CIP、潤滑、型設計、充填など）	Molding (Compaction, Injection molding (MIM, PIM), CNC press, Warm compaction, CIP, Lubrication, Molding design, Packing, etc.)
		セッションテーマ	G2-④	焼結（焼結現象、粒成長、理論、活性化焼結、脱バインダー、反応焼結、溶浸、外場支援プロセス、HIP、焼結鍛造、焼結炉など）	Sintering (Sintering phenomenon, Grain growth, Sintering theory, Activated sintering, Debinding, Reaction sintering, Infiltration, External Fields-assisted Processing, HIP, Sinter forging, Sintering furnace, etc.)
				G2-①～G2-④それに、プロセスシミュレーション、解析法、評価法、キャラクタリゼーションを含む	Including Simulation, Analysis, Evaluation, Characterization in each G2-①～G2-④
G3	射出成形分科会 (仮) Injection Molding Division	セッションテーマ	G3-①	射出成形 (MIM)	Injection Molding (MIM)
		セッションテーマ	G3-②	付加製造 (結合剤噴射法 (BJT) 、材料押出法 (MEX))	Additive Manufacturing (Binder Jetting, Material Extrusion)
		セッションテーマ	G3-③	粉末 (MIM用、Sinter-based AM用)	Powder (For MIM, Sinter-based AM)
		セッションテーマ	G3-④	脱脂 (MIM、Sinter-based AM)	Debinding (MIM, Sinter-based AM)
		セッションテーマ	G3-⑤	焼結 (MIM、Sinter-based AM)	Sintering (MIM, Sinter-based AM)
		セッションテーマ	G3-⑥	後処理 (サイジング、熱処理)	Post-processing (Sizing, Coining Heat treatment)
G4	粉末積層3D造形分科会 Additive Manufacturing Technology Division	セッションテーマ	G4-①	付加製造技術 (粉末製造・評価、設計・デザイン、造形技術、モニタリング、熱処理、表面仕上げ、組織と特性など)	Additive Manufacturing (Powder production and characterization, design and modeling, manufacturing process, monitoring, heat-treatment, surface finishing, microstructure and properties, etc.)
G5	硬質材料分科会 Hard Materials Division	セッションテーマ	G5-①	硬質材料 (焼結高速度鋼、超硬合金、サーメット、セラミックス、コーティング、ダイヤモンド、cBN など)	Hard Materials (Sintered high speed steel, Cemented carbide, Cermet, Ceramics, Coating, Diamond, cBN, etc.)
G6	磁性材料分科会 Magnetic Materials Division	セッションテーマ	G6-①	磁性材料 (軟磁性材料、高磁性材料、磁気記録材料、磁歪材料など)	Magnetic Materials (Soft magnetic Materials, Hard Magnetic Alloys, Magnetic Recording Materials, Magnetostrictive Materials, etc.)
G7	新機能材料創製分科会 New Functional Materials Development Division	セッションテーマ	G7-①	電子材料	Electronic Materials
		セッションテーマ	G7-②	電気材料	Electrical Materials
		セッションテーマ	G7-③	磁性材料	Magnetic Materials
		セッションテーマ	G7-④	光機能材料	Optical Functional Materials
		セッションテーマ	G7-⑤	エネルギー関連材料	Energy Related Materials

重点テーマは、分科会として新しいトピックや議論が必要なものなどを取り上げて設定しています。

	中分類：Subcategories(分科会名)		記号	小分類	Further Categories
G8	傾斜機能材料分科会 Functionally Graded Materials Division	重点テーマ	G8-S①	傾斜機能材料(表面改質、3次元造形、熱電材料、バンドエンジニアリング)	Functionally graded materials (surface modification, additive manufacturing, thermoelectric materials, and band engineering)
		テーマ説明		組成や構造などの傾斜化により、新たな機能が発動する材料	Novel functionally graded materials with compositional and structural gradients
G9	遷移金属（希土類）材料分科会 Transition-Metal and Rare-Earth Materials Division	セッションテーマ	G9-①	電子材料	Electronic Materials
		セッションテーマ	G9-②	電気材料	Electrical Materials
		セッションテーマ	G9-③	磁性材料	Magnetic Materials
		セッションテーマ	G9-④	エネルギー関連材料	Energy Related Materials
		セッションテーマ	G9-⑤	焼結	Sintering
		セッションテーマ	G9-⑥	シミュレーション、解析法、評価法、キャラクタリゼーション	Simulation, Analysis, Evaluation, Characterization
G10	電子部品材料分科会 Electronic Components and Materials Division	セッションテーマ	G10-①	電子材料(半導体、センサー、誘電体、圧電体、抵抗体、絶縁体、光電実装、接合、熱関連など)	Electronic Materials (Semiconductor, Sensors, Dielectric, Piezoelectric, Resistors, Insulators, Photoelectric Packaging, Bonding Technology, Thermal Management, etc.)
		セッションテーマ	G10-②	電子部品(コンデンサ、インダクター、抵抗、アクチュエーター、基板、パッケージ、モジュール、光デバイスなど)	Electronic Components (Capacitor, Inductor, Resistor, Actuator, Substrate, Package, Module, Optical Device)
G11	バイオ機能材料分科会 Bio-functional Materials Division	セッションテーマ	G11-①	バイオ機能材料 (生体材料、バイオインスピアード材料、バイオリアクター担体材料、生物由来材料など、バイオに関連する材料)	Bio-functional Materials (Bio-related Materials, such as Biomaterials, Bio-inspired Materials, Bioreactor Carrier Materials, Biologically Derived Materials, etc)
G12	環境・資源循環・エネルギー分科会 Environment, Resource Recycling and Energy Division	重点テーマ	G12-S①	エコデザイン材料	Eco-design Materials
		テーマ説明		製品のライフサイクル全体を通じて環境負荷を最小化することを目的として設計された材料や部材	Materials and components designed to minimize environmental impact throughout the entire product life cycle.
		セッションテーマ	G12-①	資源循環プロセス	Circular Economy Process
		セッションテーマ	G12-②	カーボンニュートラル材料	Carbon Neutral Materials
(発表希望の分科会が不明な方、また新領域の発表をご希望の方はEIから該当するTopicsを選択ください：For those who are unsure of the division or the theme they would like to present in, or who would like to present in Emerging & Interdisciplinary Topics, please select the appropriate topic from the EI list.)					
EI	新領域・境界領域 Emerging & Interdisciplinary Topics		EI Topics-①	基礎 × 方法 (新しい合成理論の構築、計算科学によるプロセス予測)	Novel Synthesis & Theory (Development of new synthesis theories; Process prediction using computational science)
			EI Topics-②	基礎 × 特性 (結晶構造解析、界面の微視的挙動、物理的・化学的原理)	Fundamental Mechanisms (Crystal structure analysis; Microscopic interfacial behavior; physical/chemical principles)
			EI Topics-③	応用 × 方法 (デバイス作製プロセス、量産技術、新材料の実装手法)	Advanced Manufacturing (Device manufacturing processes; Mass-production technologies, Implementation methods for new materials)
			EI Topics-④	応用 × 特性 (実用環境下での物性評価、耐久性試験、デバイス特性)	Performance & Reliability (Physical property evaluation under practical operation conditions; Durability testing; Device performance characteristics)